

HALF PITCH DIP SWITCH

# KH

---

SERIES

## HALF PITCH DIP SWITCH

특색 · 품명 · 기존품과의 비교 .....	12
구조도 · 재료사항 · 부착기판 ROUND 치수 · ..... 품명 및 치수	13
공통사양 .....	14

## 포장BOX · TUBE(카트리지) 포장수량

KHS

극수	TUBE 1개당 개수	1BOX 포장 수량
02	125개	12,500개
04	70개	7,000개
06	50개	5,000개
08	40개	4,000개
10	30개	3,000개

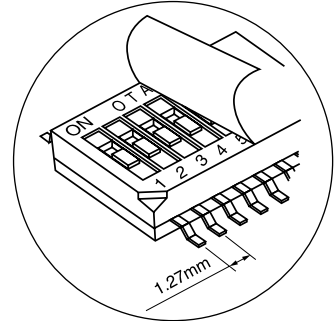
※ 1 BOX에 들어가는 TUBE 수량은 100개입니다.  
TAPE REAL 포장은 2,000개입니다.

# OTAX



## 특 색

1. 내부기구의 극초소형화에 의해 HALF PITCH (p=1.27mm)의 극초소형화를 실현
2. 고밀도 실장 가능 (당사 8극대비 면적 41.9%)
3. 엔지니어링 플라스틱 사용으로 내열성 강화
4. 접점은 금도금 표준사양
5. SMT에 따른 자동실장, REFLOW 및 세정 (테이핑에 의한) 가능  
자동실장에 관해서는 TAPE, TUBE 등의 대응 가능 (300mil SOP에 준거)

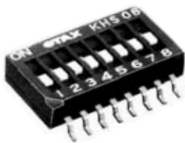


## 품 명

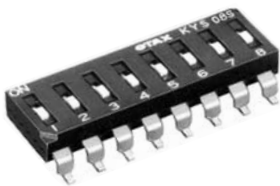
<b>K</b>	<b>H</b>	<b>S</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>E</b>		
SERIES명		기호	조작부형상	기호	극수	E	EMBOSS · TAPING TYPE
		S	SLIDE	02	2	C	TUBE TYPE
				04	4		
				06	6		
				08	8		
				10	10		

## 기존품과의 비교

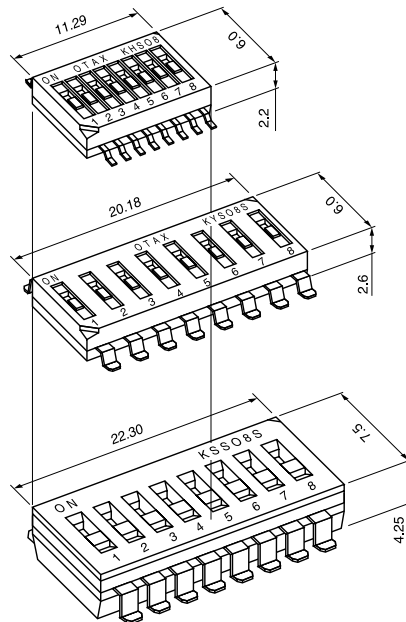
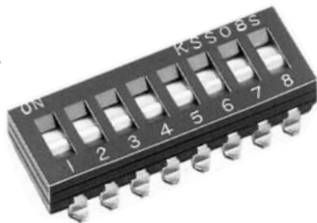
KHS08

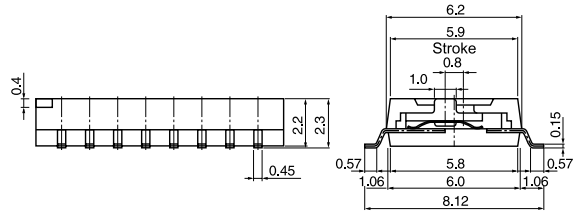
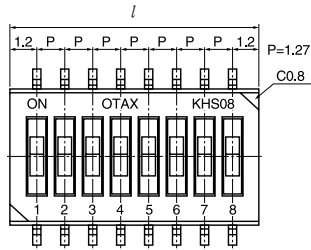


KYS08S

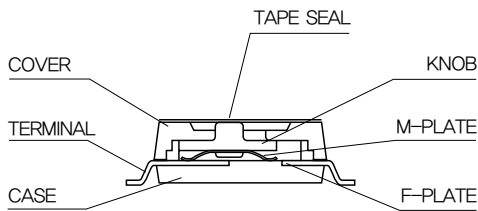


KSS08S





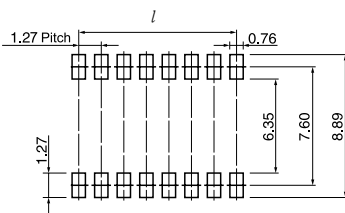
### ■ 구조도



### ■ 재료사항

부품명	재질	사양
COVER	PPS UL94V-0	흑색
KNOB	액정포리머 UL94V-0	백색
CASE	PPS UL94V-0	흑색
M-PLATE	동합금	금도금
F-PLATE	동합금	금도금
TERMINAL	동합금	납도금

### ■ 부착기판 ROUND 치수



※ 300mil SOP에 준거

### ■ 품명 및 치수

품명	극 수	L(m/m)	l(m/m)
KHS02	2P	3.67	1.27
KHS04	4P	6.21	3.81
KHS06	6P	8.75	6.35
KHS08	8P	11.29	8.89
KHS10	10P	13.83	11.43

■ 공통사양

정격	DC 24V 25mA (개폐시) 이하 DC 50V 100mA (통전시) 이하
접촉저항	초기의 접촉저항은 DC 2V 10mA에서 연속 3회 개폐를 하여 각 접촉시에 전압강하법으로 측정하고, 그 실측치는 100mΩ 이하로 한다.
절연내압	절연된 단자간 및 단자 Earth간에 AC300V를 1분간 인가하여도 이상이 없을 것
절연저항	절연된 단자 또는 단자 Earth간을 DC100V 절연저항계로 측정하여 100MΩ 이상으로 한다.
전기적 수명시험	DC 24V 25mA의 전류를 흘려 1분간 20~30회 분할하여 1,000회의 개폐동작이 가능 할 것
동작력	4.9N 이하(500gf 이하)
스트로크	0.8mm
기계적 수명시험	무부하 상태에서 2,000회 이상의 개폐동작이 가능하고 전기적, 기계적으로 이상이 없을 것
내열성	주위온도 +100°C±3°C의 환경에서 250시간 방치하여, 일반 전기적 특성 및 절연물의 변형, 깨짐, 뒤틀림 등의 이상이 없을 것
내한성	주위온도 -45°C±3°C의 환경에서 250시간 방치하여, 일반 전기적 특성 및 절연물의 변형, 깨짐, 뒤틀림 등의 이상이 없을 것
내습시험	주위온도 +40°C±2°C의 상대습도 90~95%의 환경에서 250시간 방치한 후, 물방울을 닦고, 상습 중에 30분간 방치한 후 절연저항을 측정하여 10MΩ 이상일 것
진동시험	진동수 10~55Hz 전진폭 1.5mm 1분간 주기로 3방향(전후·좌우·상하) 각 2시간
충격시험	가속도 50G 기본충동파의 지속시간 11±1ms 3방향 각각 3회(계 18)
염수분무시험	주위온도 +35°C±3°C 식염수 5%의 환경에서 48시간 방치
환경시험	(이산화유황가스) 주위온도 40°C 이산화유황가스 농도 5~10PPM의 환경에서 48시간 방치 (유화수소가스) 주위온도 40°C 유화수소가스 농도 1±0.3PPM의 환경에서 48시간 방치
◆납땜 REFLOW시험	두께 1.6mm의 P/C보드에 실장하여, SWITCH 표면온도 피크치(Peak) 240°C, 예열 160°C이하 125초이내의 조건에서 원적외선 HEATER AIR REFLOW에서 3~4분간 방치하여 이상이 없을 것
◆후락스 침전시험	발포하는 후락스 중에 10초간 테이핑한 상태로 침전한다.
◆세정시험	염화메틸렌 500g 중에 후락스(30%원액) 50g을 넣은 액에서, 5분간 초음파를 가해서 이상이 없을 것
사용온도범위	-30°C ~ +85°C

※ <주의> ◆는 참고시험

● 제품취급상의 주의

1. 세정액은 알코올류, 석유계, 케톤계, 염소계 용제가 사용됩니다. 단, 테르펜계 세정제를 사용할 경우, 문의 또는 확인 후 사용하시기 바랍니다.
  2. REFLOW로 납땜조건에는 실제 작업공정에 있어 P/C board의 치수, 조립밀도에 따라서 다르기 때문에 대리점 혹은 직접 당사에 문의바랍니다.
- ※ 기술개선 등으로 인해 사양의 일부가 예고없이 변경될 경우가 있습니다.

※ <참고> 납땜추천조건

- A. REFLOW 온도 · 시간 : 예열 160°C 이하, 125초 이내  
스위치 표면온도 피크치 240°C 이하
  - B. 수납땜 온도 · 시간 : 인두촉 온도 270°C 이하 3초 이내
- ※ 납땜조건은 33페이지를 참고하시기 바랍니다.  
자세한 내용은 별도 문의 바랍니다.